



COMPEQ

One-Stop PCB Service Provider



免責聲明

- 除歷史事件之陳述外，本文件均為前瞻性敘述。該前瞻性敘述包括已知及未知風險、不確定性及其他可能導致華通電腦股份有限公司之實際表現、財務狀況或營運結果與該前瞻性敘述所包含者產生重大差別之因素。
- 本免責聲明中之財務預測及前瞻性敘述為目前華通電腦股份有限公司截至本文件之日之信念所編製。華通電腦股份有限公司不負責更新這些預測及前瞻性敘述以反映此日期後所發生之事件或情況。
- 歷史事件的陳述可能包括未經會計師審閱之資訊，其可能有某些不足或缺陷而無法忠實呈現目前華通電腦股份有限公司之財務狀況或營運結果。

華通專注於提供一站式服務，滿足客戶各項產品需求

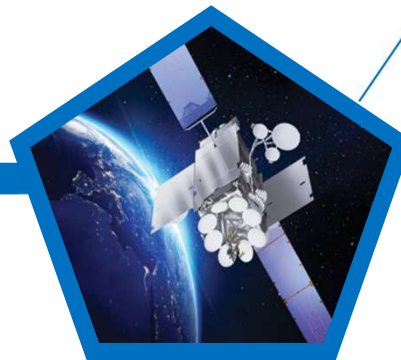
軟性電路板

電池管理模組
顯示器模組
攝像模組
穿戴裝置
周邊電子配件



硬性電路板

衛星通訊
資料處理中心
光通訊模組
汽車電子
智慧手機
筆電、平板
穿戴式裝置



COMPEQ

One-Stop
PCB Service Provider

表面黏著技術

電池管理模組
汽車電子
醫療電子
周邊電子配件

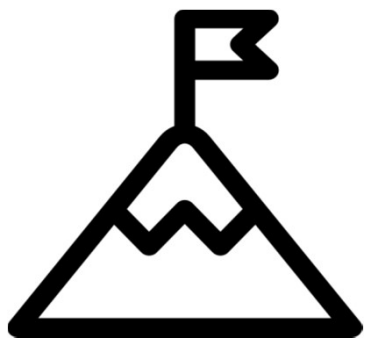


軟硬結合電路板

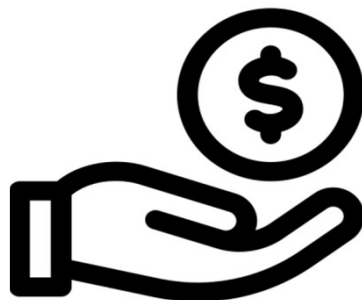
電池管理模組
顯示器模組
攝像模組
穿戴裝置



華通為全球技術領先的PCB供應商



全球PCB供應商**No.7**



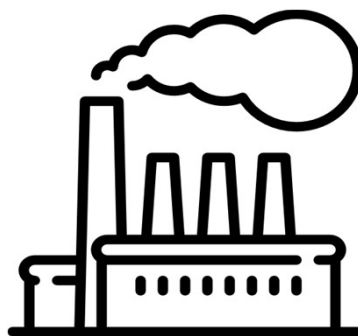
2024年營收
724億台幣



2014-2024 營收
年複合成長率**7.3%**



20,000 員工人數



8座高科技且具成本競爭力的工廠設置於**台灣、大陸和泰國**

Compeq Thailand

Location: AIES Samut Prakan (30KM away from BKK airport)

Land area: 180K SQM

Investment: 300 MUSD

Mass production: Q1'25

Capacity: 400KSF/M

華通全球廠區及據點分布



華通競爭優勢

品質

在優異的品質管制系統下，提供高品質，高一致性，高信賴度、低缺點率的產品。

技術

領先導入類載板制程，提供20/20 μ m細線路任意層薄板到40層200mil高信賴度厚板，以及軟板和軟硬結合板。

ESG

符合法令規範，重視環境保護，注重勞工權益，公司治理。

服務

提供硬板、軟板、軟硬結合板，和打件的一站式電路板服務，並且和客戶共同開發新產品，參與早期設計開發階段，提供到製造、打件、出貨的完整服務。

長久關係

穩定經營與成長，擅於研發新技術，掌握客戶需求，提前做好準備，成為客戶共同發展的合作夥伴。

華通技術路線圖-高多層板

Items	Current	2026	2027
Min. Core Thickness	50 μ m	50 μ m	50 μ m
Buried Capacitance	25 μ m	12 μ m	12 μ m
Min. Outer layer Line Width / Space	75 / 75 μ m	75 / 75 μ m	75 / 75 μ m
Min. Inner layer Line Width / Space	50 / 50 μ m	50 / 50 μ m	50 / 50 μ m
Min. Drill Size for Thru-Hole	150 μ m	150 μ m	150 μ m
Min. PTH Drill Pad Size	350 μ m	300 μ m	300 μ m
Max. Board Thickness	6 mm	7 mm	8 mm
Max. Layer Count	48	52	56
Max. Plating Aspect Ratio	28:1	33:1	42:1
Back Drill Size	Drill + 150 μ m	Drill + 100 μ m	Drill + 100 μ m
Back Drill Stub Length	125 \pm 75 μ m	100 \pm 50 μ m	100 \pm 50 μ m
Material Trend	Low CTE; Low Dk/Df; Hybrid; Capacitance		



華通技術路線圖-HDI+HLC

Items	Current	2026	2027
Stack up	7-N-7	8-N-8	8-N-8
Max. Layer Count	42	44	48
Max. Micro-Via size	125 μm	150 μm	150 μm
Max. Skip Via size	15 mil	15 mil	16 mil
Max. Skip Via Aspect Ratio	1	1.2	1.5
Micro-Via to Pad Alignment	Drill + 150 μm	Drill + 125 μm	Drill + 100 μm
Line Width/Spacing (Build up)	75 / 75 μm	50 / 50 μm	40 / 50 μm
Max. Board Thickness	6 mm	7 mm	8 mm
Max. Plating Aspect Ratio	28:1	33:1	42:1

Operation Revenue

	Mobile Phone	PC	Data Center / Networking	RF+FPC	SMT	Aerospace	Consumer & Others
2024 Q1	22%	15%	2%	20%	17%	20%	4%
2024 Q2	17%	15%	3%	24%	17%	20%	4%
2024 Q3	15%	15%	2%	29%	18%	17%	4%
2024 Q4	21%	15%	3%	25%	16%	17%	3%
2025 Q1	19%	15%	3%	22%	16%	23%	3%
2025 Q2	16%	16%	4%	25%	14%	22%	4%
2025 Q3	18%	13%	5%	28%	16%	17%	4%











	Mobile Phone	PC	Data Center / Networking	RF+FPC	SMT	Aerospace	Consumer & Others
2021	26%	23%	2%	21%	21%	3%	4%
2022	20%	26%	1%	23%	20%	7%	3%
2023	21%	20%	2%	23%	21%	9%	4%
2024	19%	15%	2%	25%	17%	18%	4%

PCB市場主要供應商/ 華通排名

Rank	Country	Supplier	2024 Revenue (MUSD)
1	TWN 	Zhen Ding	\$5,340
2	TWN 	Unimicron	\$3,594
3	CHN 	Dongshan Precision	\$3,412
4	CHN 	Shennan	\$2,510
5	JPN 	Nippon Mektron	\$2,485
6	USA 	TTM	\$2,443
7	TWN 	Compeq	\$2,256
8	TWN 	Tripod	\$2,050
9	CHN 	WUS	\$1,960
10	CHN 	Kinwong	\$1,739
11	AUT 	AT&S	\$1,676
12	CHN 	Kingboard	\$1,577
13	KOR 	SEMCO	\$1,492
14	CHN 	Victory Giant	\$1,489
15	JPN 	Meiko	\$1,297

Source: Prismark, 2025

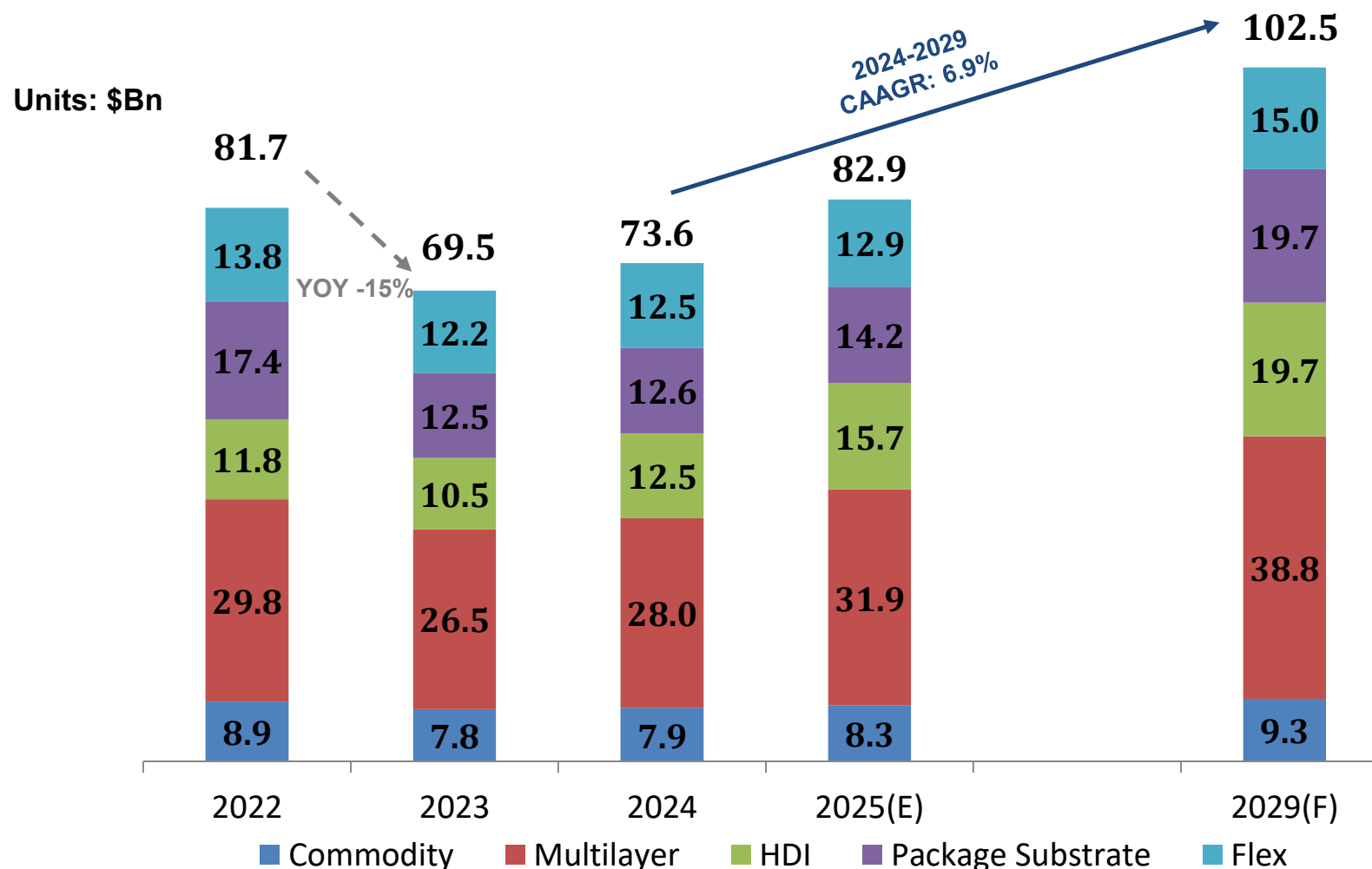
HDI PCB市場主要供應商/ 華通排名

Rank	Country	Supplier	2024 Revenue(MUSD)
1	TWN 	Compeq	1,194
2	CHN 	WUS	904
3	USA 	TTM	900
4	TWN 	Unimicron	885
5	TWN 	Zhen Ding	878
6	AUT 	AT&S	862
7	TWN 	Tripod	697
8	CHN 	AKM Meadville	572
9	JPN 	Meiko	511
10	KOR 	Young Poong	258

Source: Prismark, 2025

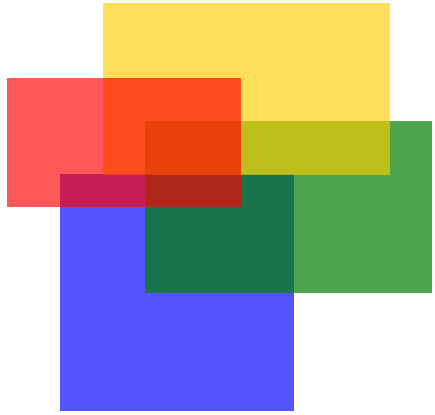
PCB產業趨勢

Prismark指出因AI科技的應用、高速運算/傳輸、衛星通訊、車用電子等產品需求成長，2024年PCB產值成長幅度約5.8%。2025年在AI相關應用、AI伺服器、交換器和其他網路產品的強勁需求帶動下，預期將會成長12.8%。長期發展仍充滿不確定性，Prismark仍預期電子產業將持續成長，預估PCB產值 2024-2029年複合成長率6.9%，達到1025億美元。



Source: Prismark, 2025

COMPEQ



COMPEQ

Thank You For Your Attention